

Title (en)
Electronic component

Title (de)
Elektronisches Bauelement

Title (fr)
Composant électronique

Publication
EP 0884741 A1 19981216 (DE)

Application
EP 97109720 A 19970614

Priority
EP 97109720 A 19970614

Abstract (en)
The electronic component (1) has an integrated component body (2) with at least two contact wires which are connected to at least two contact elements (9), with which the component can be attached to a circuit board. The contact elements are guided on the surface (7) of the component body on the underside so that the component body can be mounted with its underside (8) directly on the circuit board. Apertures (5) in the sides of the component are coated with conducting material to make the connection between the contact wires and the contact elements.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauelement mit einem integrierten Bauelementkörper (2). Dieser verfügt über mindestens zwei Kontaktfäden, die mit zwei unteren Kontaktflächen (9) verbunden sind. Über diese Kontaktflächen (9) ist der Bauelementkörper (2) auf einer Leiterplatte befestigbar. Die Kontaktflächen (9) sind auf der Oberfläche (7) des integrierten Bauelementkörpers (2) auf die Unterseite (8) geführt, so dass der Bauelementkörper (2) mit seiner Unterseite (8) direkt auf die Leiterplatte aufsetzbar ist. Dies ist besonders vorteilhaft bei Vorsehen einer unteren Ausnehmung (10), in die ein Kern (3) für einen planaren Transformator einsetzbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7
H01F 27/29

IPC 8 full level
H01F 27/29 (2006.01)

CPC (source: EP)
H01F 27/29 (2013.01)

Citation (search report)

- [X] EP 0582881 A1 19940216 - MURATA MANUFACTURING CO [JP]
- [XA] EP 0741396 A1 19961106 - AT & T CORP [US]
- [XA] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 011 29 November 1996 (1996-11-29)

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0884741 A1 19981216

DOCDB simple family (application)
EP 97109720 A 19970614